

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

649

ML6

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

21.01.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	135		2	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3	
		105	L2		
C-RS-FR4-ML-0.20mm-105+105-TG150-HF	50201429	200		4	A01
		105	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	268		5	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		6	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		7	
		105	L4		
C-RS-FR4-ML-0.20mm-105+105-TG150-HF	50201429	200		8	A02
		105	L5		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	135		9	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		10	
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	11	

B00

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1428 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik